

明新學校財團法人明新科技大學 函

地址：30401新竹縣新豐鄉新興路1號

聯絡人：何宗穎

電子信箱：zyho@must.edu.tw

聯絡電話：(03)5593142分機3270

傳真電話：(03)5595142

受文者：國立羅東高級工業職業學校

發文日期：中華民國113年5月16日

發文字號：明新（半）字第1130005638號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(2件) 附件如說明一 (1131200843_2_ATTCH2.png、1131200843_1_ATTCH1.pdf)

主旨：有關本校辦理112學年度教師產業研習「半導體封裝技術與核心實務培訓營」第二梯次培訓課程，請轉知貴校工程專業領域之教師報名參加，活動資訊詳如說明，請查照。

說明：

一、旨揭培訓課程由專家學者與業師共同授課，內容包含半導體封裝技術及核心實務兩個部份：封裝製程主要講授封裝技術之衍變所衍生的專業知識；核心實務則提升晶圓切割機、固晶機與打線機之實務操作能力；QFN自動機台操作則是藉由機台、製程參數設定提升機台運轉效能，檢附研習課程之活動簡章（附件1）及活動海報（附件2）。

二、研習相關資訊：

（一）第二梯次：113年7月1日（星期一）至113年7月12日（星期五），共10天，上午8時30分至下午4時30分。

（二）研習地點：本校逢喜樓209教室、半導體封裝測試類產線基地。



(三)參加培訓人數40人（名額有限滿額為止）。

三、報名方式：

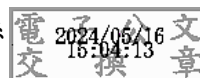
(一)報名時間：113年6月25日截止

(二)報名網址：<https://forms.gle/Wjm3viG6Tv8pvD146>

四、報名洽詢：本校半導體學院類產線計畫辦公室何宗穎助理，電話：(03)5593142分機3270

正本：各公私立高級職業學校、各公私立大專校院

副本：本校半導體學院、本校產學及技術轉移中心、本校電子工程系



裝

訂



線